

表 2 含有禁止物質の管理基準

(注) ①用途・使用例は全てを網羅していないため、不明な点は発行元に確認のこと。

②管理レベルにおいて、除外用途を示していない物質は、“適用除外用途なし”となる。

③各物質群の詳細については表 6 を参照のこと。なお、オゾン層破壊物質に関しては表 7 を参照。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
1	ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類)	禁止	絶縁油、潤滑油、電気絶縁媒体、溶剤、電解液	—	即時
		除外	副生成物として含まれる場合	50ppm	—
2	ポリ塩化ターフェニル類 (PCT 類)	禁止	絶縁油、潤滑油、電気絶縁媒体、溶剤、電解液	—	即時
3	ポリ塩化ナフタレン (塩素数：1 以上)	禁止	潤滑油、塗料、樹脂安定剤、電気絶縁媒体、難燃剤	—	即時
4	ポリ臭化ビフェニル類 (PBB 類)	禁止	難燃剤	1000ppm	即時
5	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)	禁止	難燃剤	1000ppm	即時
6	短鎖型塩化パラフィン (炭素鎖長：10-13)	禁止	塩ビ可塑剤、難燃剤	1000ppm	即時
7	アスベスト類	禁止	ブレーキライニング・パッド、絶縁体、充填剤、摩擦材、電気絶縁材、充填ファイバー、顔料・塗料、タルク、断熱材	—	即時
8	オゾン層破壊物質	禁止	冷媒、発泡剤、消火剤、洗浄剤	—	即時
		除外	副生成物として含まれる場合	—	—
9	カドミウム 及びその化合物	禁止	・包装材	表 4-1-3	即時
			・携帯型電池、蓄電池	20ppm	
			<ul style="list-style-type: none"> ・塗料、インキ ・樹脂（ゴムを含む）材料中の顔料、染料、安定剤等の添加剤 ・電気カドミウムめっき処理及びカドミウムコート処理された材料及び部品 ・カドミウムを含む光沢剤を使用した無電解ニッケルめっき部品 ・ガラス及びガラス塗料の顔料、染料 ・カドミウムを含む銀ロウ材料 ・亜鉛及び亜鉛合金、亜鉛化合物などの材料及び部品（快削黄銅棒、ゴムベルト等） ・DC モーター、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点 ・温度ヒューズの可溶体 ・蛍光灯（小型蛍光灯、直管蛍光灯） ・ニッケル／カドミウム電池 ・蛍光表示装置に含有される蛍光体 	100ppm	
10	六価クロム 及びその化合物	禁止	・皮膚と接触する革製品、革パーツを含む製品	3ppm (革の総乾燥重量において)	即時
			・包装材	表4-1-3	即時
			<ul style="list-style-type: none"> ・塗料、インキ ・電気亜鉛めっき後クロメート処理された材料及び部品（一般機械部品、電装購入品及び電源装置等）に使用される板金、ねじ、軸物、ベアリング等） ・クロメート化成処理（塗装前処理）されたアルミ、銅合金、亜鉛合金等の材料及び部品 	1000ppm	

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
11	鉛及びその化合物	禁止	・包装材料	表 4-1-3	即時
			・ポリ塩化ビニル電線被覆中の鉛	300ppm [※1]	
			・塗料、インキ ・樹脂（ゴムを含む）材料中の顔料、染料、安定剤等の添加剤 ・鉛合金めっき処理された材料及び部品（すずめっきピアノ線等） ・潤滑剤としての鉛を含む部品（ドライベアリング等） ・鉛を含有する各種合金（但し、除外対象の合金は除く） ・はんだ材料（Pb=85%未満のはんだ） ・はんだ付けされた部品、ユニット（プリント基板、電源装置、モータ、クラッチ、センサー等） ・サーバー、ストレージ（HDD）中の鉛 ・FFC コネクタ接点部	1000ppm	
			・ガラス蛍光管であって鉛含有量が、0.2wt%を超えないもの	—	
			・機械加工目的のために合金成分として鋼材中に含まれる0.35wt%までの鉛、ホットディップ溶融亜鉛めっき鋼中に0.2wt%まで含まれる鉛		
			・鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルに由来するアルミニウムに合金元素として含まれる0.4wt%までの鉛 ・機械加工用とのアルミニウムに合金元素として含まれる0.4wt%以下の鉛		
			・銅合金に含まれる鉛（4.0wt%以下）		
			・高融点のはんだに含まれる鉛（鉛含有量が重量で85%以上の鉛ベースの合金）		
			・コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中又は、セラミック中に鉛を含む電気電子部品（例：圧電素子）、もしくはガラス又は、セラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品		
			・定格電圧がAC125V又は、DC250V又は、それ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛		
		・定格電圧がAC125V又は、DC250V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛 但し、2013年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツに限る			
		・光学用途に使用される白色ガラス中に含まれる鉛			
		・マイクロプロセッサのピン及び、パッケージ間の接合用に用いる2種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が80wt%超目づつ、85wt%未満のもの 但し、2011年1月1日より前に上市された製品のスペアパーツに限る			
		・集積回路パッケージ（フリップチップ）の内部半導体ダイ及び、キャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛 ただし、以下のクライテリアの少なくとも一つは該当すること -90nm以上の半導体テクノロジーノード -300mm ² 以上の単一ダイを有する半導体テクノロジーノード -300mm ² 以上のダイもしくは300mm ² 以上のシリコンインターポーザーを有するスタック型ダイパッケージ			

※1. 米国カリフォルニア州 Proposition65 による。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期	
12	水銀及びその化合物	禁止	・包装材	表 4-1-3	即時	
			・電池、蓄電池	5ppm [※2]		
			・顔料、塗料、インキ、プラスチックへの調剤 ・水銀を接点としたリレー、スイッチ、センサー	1000ppm		
		除外	一般照明用途のダブルキャップ式の直管蛍光灯ランプ中の水銀	3 波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 9mm 未満（例：T2）	4mg	—
				3 波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 9mm 以上 17mm 以下（例：T5）	3mg	
				3 波長形蛍光灯を使用した標準寿命且つ、ランプ径 17mm 超 28mm 以下（例：T8）	3.5mg	
				3 波長形蛍光灯を使用した標準寿命のランプ径 28mm 超（例：T12）	3.5mg	
				3 波長形蛍光灯を使用した長寿命（25000 時間以上）のランプ	5mg	
			特殊用途の冷陰極蛍光灯ランプ及び、外部電極蛍光灯ランプ（CCFL）及び、EEFL に含まれる水銀	短尺ランプ（500mm 以下）	3.5mg	
				中尺ランプ（500mm 超 1500mm 以下）	5mg	
長尺ランプ（1500mm 超）	13mg					
・プロジェクターの光源として用いられる高圧水銀ランプ	—					
13	パーフルオロオクタンスルホン酸及びその塩（PFOS）	禁止	・織物、コーティングされた材料	1µg/m ² または 1000ppm	即時	
			・アーティクル（上記以外）	1000ppm		
		除外	・フォトソグラフィープロセス用のフォトレジストまたは反射防止用コーティング剤 ・フィルム、紙または印刷原版用の写真コーティング剤	—	—	
14	特定アミンを形成する一部のアゾ染料・顔料	禁止	・人の皮膚（または口腔）に直接かつ長時間接触する可能性のある織物製品および皮革製品・部品 [※3]	30ppm	即時	
		除外	・上記以外の用途	—	—	
15	三置換有機スズ化合物	禁止	・防腐剤、かび防止剤、塗料、顔料、防汚顔料、冷媒、発泡剤、消火剤、洗浄剤、安定剤、酸化・老化防止剤、防菌・防カビ剤、防汚剤	1000ppm [※4]	即時	
16	ジブチルスズ化合物	禁止	・塩化ビニル樹脂用安定剤、滑剤、触媒	1000ppm [※4]	即時	
17	ジオクチルスズ化合物	禁止	・2 成分室温加硫鋳物キット（RTV-2 mouldingkits） ・皮膚と接触することを意図された織物のアーティクルの 2 つの用途	1000ppm [※4]	即時	
		除外	・上記 2 つ以外の用途	—	—	

※2. 電池に含まれる水銀の閾値に関しては、欧州電池指令の定義と同様に、電池の総質量に占める水銀の質量（つまり電池一本あたりの濃度）にて算出する。

※3. 図面や仕様書で指示したもののみ対象とする。

※4. 金属換算したスズ質量による濃度とする。

No.	物質名	管理レベル	用途・使用例	含有閾値	納入禁止時期
18	ジメチルフマレート（フマル酸ジメチル（DMF））	禁止	・革製品の防腐剤 ・乾燥剤（シリカゲルパック）	0.1ppm	即時
19	多環芳香族炭化水素（PAHs）	禁止	・人の皮膚または口腔内に直接ならびに長時間または短期間繰り返し接触するゴムまたはプラスチック構成部品【※3】	1ppm	即時
		除外	・上記以外の用途	—	—
20	パーフルオロオクタン酸（PFOA）関連物質 1：ノルウェー法で規制されている 8 物質【※5】	禁止	・織物、コーティングされた材料	1μg/m ³	即時
			・アークティック（上記以外）	1000ppm	
	パーフルオロオクタン酸（PFOA）関連物質 2：EU REACH 規則で規制されている物質【※5】	禁止	・アークティック（下記以外）	PFOA およびその塩：25ppb、関連物質の 1 つまたは組合せ：1000ppb【※6】	2020/5/1 から
除外【※7】	・フィルムまたは紙または印刷版用の写真コーティングが施された成形品 ・半導体のためのフォトリソグラフィ工程、または化合物半導体のためのエッチング工程での使用により製造された半導体および化合物半導体	—	—		
21	ヘキサブロモシクロドデカン（HBCDD）	禁止	樹脂用難燃剤、接着剤の硬化促進剤	—	即時
22	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)（DEHP）	禁止	塩ビの可塑剤、コンデンサーの誘電体	1000ppm【※8】	即時
23	ブチルベンジルフタレート（BBP）	禁止	ポリサルファイド系樹脂可塑剤、シーリング剤	1000ppm【※8】	即時
24	ジブチルフタレート（DBP）	禁止	樹脂用の可塑剤、塗料・インクの可塑剤	1000ppm【※8】	即時
25	ジイソブチルフタレート（DIBP）	禁止	塗料用可塑剤	1000ppm【※8】	即時
26	ハロゲンを含むポリマー及びハロゲン化合物を添加したポリマー	禁止	包装プラスチック部品	—	即時
		除外	上記以外の用途	—	—

2020年4月版

・リコーイメージング株式会社独自の物質リストになります。

※5. 対象物質の詳細は表 10 参照。

※6. 成形品中の閾値とする。

※7. 除外に該当する場合にもノルウェー法で規制されている 8 物質はノルウェー法の基準を満たさなければならない。

※8. EU RoHS 指令対象外製品（包装材、販促品など）の場合は、可塑化された材料中で DEHP, BBP, DBP, DIBP の合計としての閾値とする。